

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2026-052

债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于公司CMP抛光液产品取得重大进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司—武汉鼎泽新材料技术有限公司（以下简称“鼎泽新材料”），近期在半导体 CMP 抛光液领域持续取得突破性进展：（1）核心产品斩获头部晶圆厂客户优秀供应商奖项；（2）铜阻挡层抛光液获得新客户批量订单；（3）碳化硅（SiC）衬底抛光液成功落地批量订单，抛光液核心原材料—自研磨料正式切入第三代半导体市场。

本次涉及的抛光液产品里，搭载氧化铝研磨粒子的抛光液、铜制程抛光液（含铜及铜阻挡层抛光液）为晶圆制造关键耗材，亦是国内抛光液市场主流品类，预计两类产品在抛光液市场规模的金额占比分别超 20%、45%，2026 年国内合计市场规模突破 40 亿元。碳化硅抛光液隶属第三代半导体新兴耗材领域，行业尚处于成长初期，具备广阔市场发展空间。

现将相关进展情况公告如下：

一、斩获头部晶圆厂客户优秀供应商奖项，核心产品实力与配套服务能力获权威认可

近期，鼎泽新材料收到国内某头部逻辑芯片代工厂颁发的“优秀供应商”荣誉奖项，以此表彰鼎泽新材料在高介电金属栅极（HKMG）、铜制程 CMP 抛光液产品稳定供应及配套服务方面的突出表现。

其中，HKMG 氧化铝抛光液是先进制程芯片制造的核心关键材料，行业长期由海外企业垄断，该类产品在客户端产线验证门槛高、替换难度大，具备极高

的技术壁垒与严苛的工艺适配要求。公司已实现氧化铝研磨粒子的自主研发，从核心原料源头完成技术突破，凭借优异的产品性能、稳定的批次一致性，成功打破海外厂商垄断。目前该产品已在国内主流头部逻辑芯片代工厂实现三年稳定批量供货，充分适配客户先进制程芯片规模化量产需求。

同时，成熟制程铜阻挡层抛光液作为芯片制造关键耗材，因工艺适配复杂、替换技术壁垒极高，长期以来国内企业在该客户未能实现该支产品的量产导入。公司凭借多年技术深耕与客户项目协同研发，成功攻克该产品核心技术瓶颈，顺利实现批量导入供货并取得正式订单。上述两款核心产品均采用公司自研自产的研磨粒子核心原料，从源头把控产品品质，有效规避外部供应链波动风险，全方位保障客户产线稳定生产。

本次系鼎泽新材料获得国内该头部逻辑芯片客户颁奖，充分印证了头部客户对公司核心技术、产品性能、品质管控及配套服务的高度认可与充分信赖。未来公司将进一步深耕先进制程抛光液技术研发，为 CMP 抛光液自主可控、突破海外技术与供应垄断束缚持续做出贡献。

二、铜阻挡层抛光液再获新客户批量订单，持续完善铜制程产品矩阵布局

公司自主研发的成熟制程铜阻挡层抛光液，依托优异的工艺适配性能、稳定的产品品质及突出的综合成本优势，顺利通过某国内成熟制程晶圆厂全流程、高标准的严苛验证，近期成功斩获该客户批量采购订单。

本次合作订单为公司在第三家客户取得的铜制程抛光液产品订单，标志着公司铜阻挡层抛光液产品的通用性、适配性得到行业广泛验证与认可，成功实现多客户、多场景市场化落地，进一步丰富并完善了公司铜制程 CMP 抛光液全系列产品布局。公司高品质、高性价比的本土化抛光液产品，不仅为国内成熟制程芯片制造企业提供了优质的国产化选材方案，助力客户优化采购体系、降低供应链依赖，同时有效推动行业耗材市场多元化发展，持续扩大公司 CMP 抛光液产品的市场覆盖范围与行业影响力。

三、SiC 衬底抛光液成功落地批量订单，自研磨料产品正式切入第三代半导体市场

公司搭载自主可控氧化铝磨料研发生产的 SiC 衬底抛光液，已成功取得国内客户批量采购订单，标志着公司自研自产磨料体系的抛光液产品正式切入第三代半导体 SiC 衬底抛光领域，实现了公司在第三代半导体材料市场从 0 到 1 的关键性突破，具备重要的里程碑意义。

后续公司将以本次市场突破为契机，持续深耕第三代半导体抛光液技术迭代升级，依托自主氧化铝磨料的核心技术优势，快速研发、落地 SiC 粗抛、精抛全系列配套产品，加速推进第三代半导体耗材国产化替代进程，紧抓全球 SiC 半导体产业高速发展的市场红利。本次业务突破助力公司构建“集成电路+第三代半导体”双轮驱动的业务发展新格局，进一步巩固公司在高端 CMP 抛光液领域的行业领先地位。

本次三大业务板块的同步突破，充分彰显了公司在半导体 CMP 抛光液领域扎实的核心技术壁垒、过硬的产品竞争力与成熟的市场化服务能力，进一步深化了公司与国内核心晶圆厂的深度战略合作，有效加速了国内先进制程、成熟制程及第三代半导体核心耗材的国产化进程。

目前，公司实现了 CMP 抛光液产品全品类布局，已有：**铜制程抛光液、金属栅极（钨、铝）抛光液、多晶硅、氮化硅抛光液、介电层抛光液、氧化铈抛光液、大硅片精抛液、TSV 抛光液、SiC 衬底抛光液**等品类实现销售，应用领域全面覆盖集成电路制造、单晶硅晶片制造、先进封装、第三代半导体等领域。产能方面，公司已具备武汉本部年产 5,000 吨抛光液生产线、仙桃年产 1 万吨 CMP 抛光液及年产 1 万吨 CMP 抛光液用配套纳米研磨粒子产线，产能储备充足，产能利用率随市场拓展而逐步提升，为后期快速放量奠定坚实基础。

未来，公司将持续聚焦半导体高端材料主赛道，持续加大核心技术研发与攻关投入，稳步推进各类抛光液产品的技术迭代与市场化落地，以高品质产品、稳定的供应链保障、专业化技术服务回馈广大客户与投资者，保障公司经营业绩持续稳健增长。

上述业务进展和订单的执行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因订单的执行而对客户形成依赖。后续公司将及时跟进上述订单的执行情况并履行相应的信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2026年5月26日